



(43) 国際公開日
2007 年 11 月 8 日 (08.11.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/125635 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 59/20 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C08G 59/30 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/000300

(22) 国際出願日: 2007 年 3 月 26 日 (26.03.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
 特願2006-100287 2006 年 3 月 31 日 (31.03.2006) JP
 特願2007-004252 2007 年 1 月 12 日 (12.01.2007) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 遠藤将 (ENDO, Masashi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 黒田洋史 (KURODA, Hirofumi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西 2 - 1 7 - 1 6 代官山 T K ビル 1 階 Tokyo (JP).

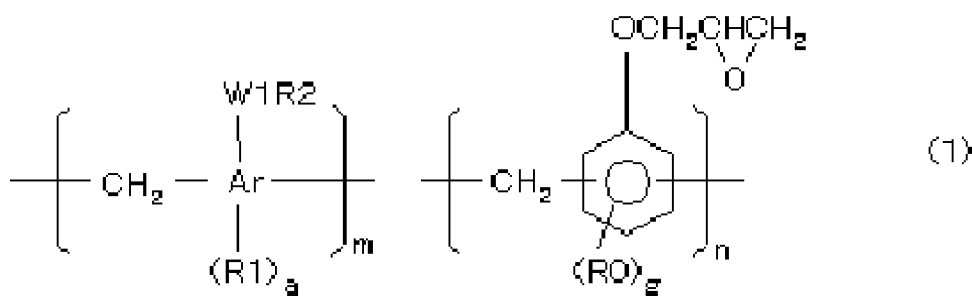
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:
 — 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則4.17(ii))

[続葉有]

- (54) Title: RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR ENCAPSULATION AND SEMICONDUCTOR DEVICE
- (54) 発明の名称: 半導体封止用樹脂組成物及び半導体装置



(57) Abstract: Disclosed is a resin composition for semiconductor encapsulation, which contains an epoxy resin (A), a compound (B) containing two or more phenolic hydroxyl groups, an inorganic filler (C) and a curing accelerator (D). This resin composition for semiconductor encapsulation is characterized in that the epoxy resin (A) contains an epoxy resin (a1) having a structure represented by the general formula (1) below, and the moisture absorption rate of a cured product of the resin composition is not more than 0.22% by weight when the cured product is subjected to a humidification treatment for 168 hours at 85°C at a relative humidity of 85%.
(chemical formula 1) (1)

(57) 要約: エポキシ樹脂 (A) と、フェノール性水酸基を 2 個以上含む化合物 (B) と、無機充填剤 (C) と、硬化促進剤 (D) と、を含む半導体封止用樹脂組成物であって、前記エポキシ樹脂 (A) が下記一般式 (1) で表される構造を有するエポキシ樹脂 (a 1) を含み、前記半導体封止用樹脂組成物の硬化物を 85℃、相対湿度 85% の環境下で 168 時間加湿処理した際の吸湿率が 0.22 重量% 以下であることを特徴とする半導体封止用樹脂組成物。 (化 1)



- 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))
- 添付公開書類:
- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。